仅供内部参考，请勿外传

华为发布韬定律 V2，先进封装、硅光、AI 算力迎来发展新机遇

——电子行业周报（20260629-20260705）

行业及产业

电子

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《电子行业周报：HBM 需求旺盛推动 Micron 业绩大幅增长》2026-06-29

《电子行业周报：SK Hynix 送样 12 层 HBM4E，AI 高端存储迭代提速》2026-06-22

《电子行业周报：NVIDIA 携手 SK Hynix 共建 AI 内存与半导体智造新生态》2026-06-15

《电子行业专题报告：Vera Rubin 量产提速，RTX Spark 打开终端 AI 新空间》2026-06-08

《电子行业周报：端侧 AI PC 产业化落地，云端算力需求持续爆发》2026-06-08

证券分析师

许亮

S0820525010002

0755-83562506

xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇

S0820125040021

021-32229888-25520

zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- **电子板块行情复盘：**本周申万电子指数下跌 4.30%，跑输沪深 300 指数（-0.54%），在申万一级行业指数中排名 29/31，板块整体震荡回调。各细分板块中，品牌消费电子（+5.43%）、模拟芯片设计（+2.48%）、面板（+1.39%）涨幅居前，被动元件（-11.18%）、集成电路封测（-8.64%）、LED（-7.39%）等板块走弱。

- **个股方面：**本周 SW 电子个股行情分化显著，格科微（+49.48%）、银河微电（+46.08%）、天禄科技（+41.86%）、恒久退（+41.18%）、维峰电子（+37.99%）为本周板块领涨标的；消费电子、PCB 相关标的整体承压回调，板块跌幅前五个股依次为昀冢科技（-30.91%）、唯特偶（-23.96%）、沃格光电（-22.98%）、富信科技（-22.16%）、超声电子（-22.03%）。

- **2026 年 7 月 3 日，华为半导体何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2 版本。**1）理论升级：新版在 V1 框架基础上补充工程落地细节、实测量化数据与产品迭代规划，完善以时间常数τ为核心的后摩尔芯片缩放体系。2）工程技术层面：V2 提出 LogicFolding（逻辑折叠）齿比核心定义，混合键合间距贴近顶层金属线宽后，3D 芯片设计可由宏块分层离散优化升级至标准单元全局连续优化，突破传统 3D 堆叠只能按功能模块分层的设计瓶颈。3）实测数据层面：论文披露麒麟 2026 对比麒麟 9030 Pro 全套硬件参数，25℃同等算力下：工作电压 1.1V 下降至 0.9V；仅 2.5GHz 主频达成前代 2.75GHz 同等性能；归一化功耗 0.59，功耗降低 41%；裸片面积缩至前代 0.625 倍，尺寸减小 37.5%；功率密度 0.944，发热小幅改善。4）技术路线层面：V2 完善移动端、AI 算力双线演进路径。移动端新增 TSV 下移至 M6 层、多层有源晶圆堆叠工艺；AI 算力明确昇腾加速器迭代节奏，围绕 Unified Bus（统一总线）、Hi-ONE 硅光引擎规划中长期发展路线。我们认为，V2 仅依托实验室样机完成理论验证，初步贯通 3D 堆叠、逻辑折叠与硅光互联技术路径，移动端及 AI 芯片中长期迭代方向明确。华为自研技术筑牢先进封装、算力壁垒，叠加国产替代浪潮，技术若实现产业化，有望提振国内先进芯片、混合键合、硅光产业链景气。

- **2026 年 7 月 3 日，国产存储芯片厂商江波龙发布 2026H1 业绩预告。**1）业绩预告数据：公司预计 2026H1 营收 220-250 亿元，同比增长 116%-145%；归母净利润 92-110 亿元，同比增长 62204%-74394%。2）业绩增长驱动：一方面存储行业需求回暖、晶圆供给收紧，行业进入高景气周期；另一方面公司与多家全球头部存储晶圆原厂续签长期供货协议（LTA）与合作备忘录（MOU），稳定上游晶圆供给。我们认为，存储行业供需格局持续改善，公司长期锁定晶圆产能充分受益存储涨价周期，国产存储芯片业务盈利弹性充分释放，有望带动国内消费级、企业级存储产业链景气持续上行。

- **投资建议：**建议关注先进封装、硅光互联、国产算力芯片产业链。华为发布时间缩微理论 V2，逻辑折叠、3D 混合键合完成实测验证，移动与昇腾 AI 双线技术路径明确，方案实现低功耗、小尺寸，叠加多层晶圆堆叠、硅光引擎量产路线，长期打开国产先进集成芯片成长空间，先进封装、硅光互联、AI 算力配套赛道增量空间广阔。

- **风险提示：1）海外厂商 3D 集成、硅光技术迭代速度超预期，2）国产逻辑折叠、多层晶圆堆叠量产良率爬坡不及预期。**

仅供内部参考，请勿外传

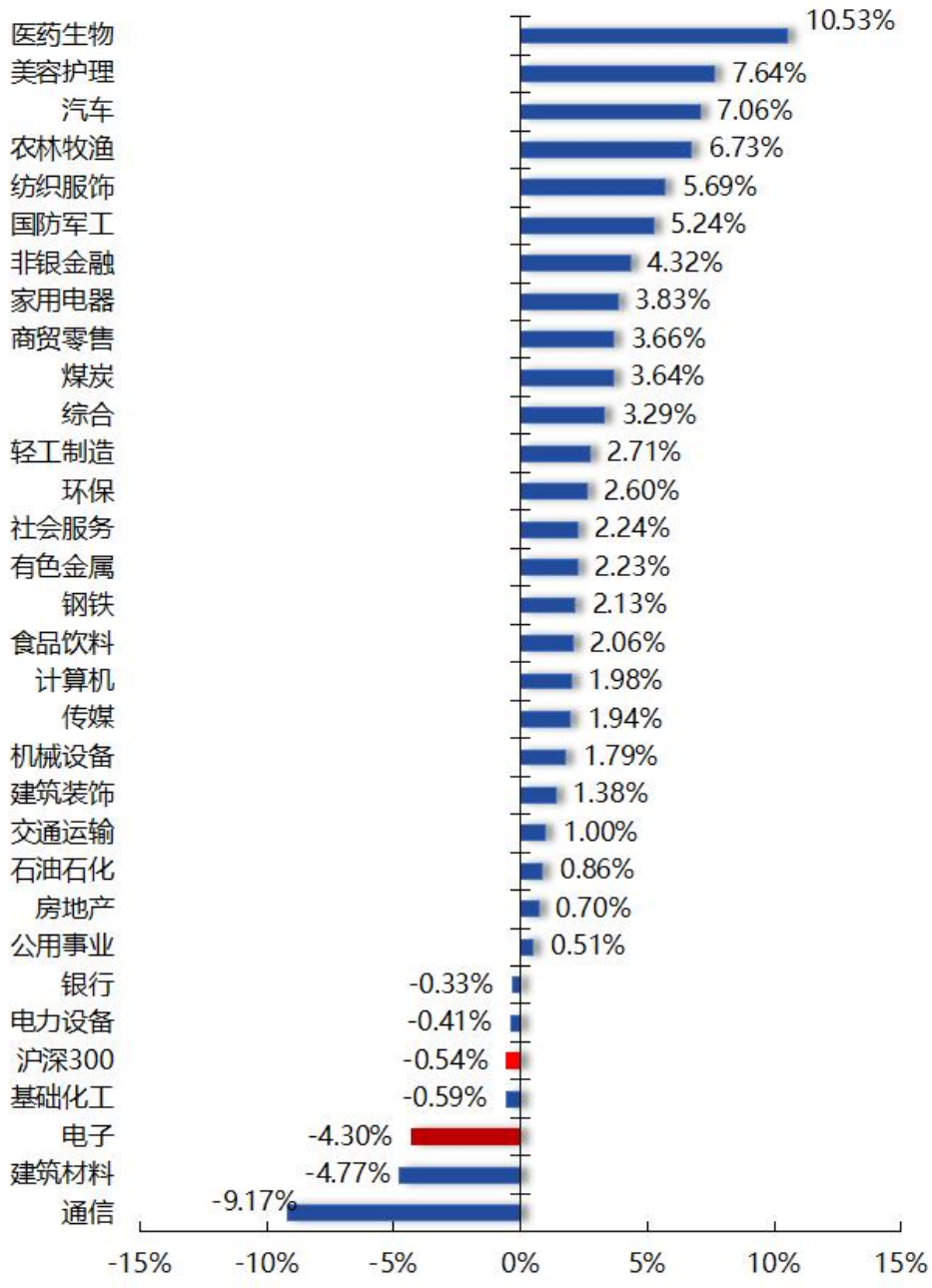
1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周申万电子指数下跌 4.30%，跑输沪深 300 指数（-0.54%），在申万一级行业指数中排名 29/31，板块整体震荡回调。

SW 一级行业涨跌幅排名前五的板块分别为：医药生物（+10.53%）、美容护理（+7.64%）、汽车（+7.06%）、农林牧渔（+6.73%）、纺织服饰（+5.69%）。排名后五的板块分别为：通信（-9.17%）、建筑材料（-4.77%）、电子（-4.30%）、基础化工（-0.59%）、电力设备（-0.41%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

仅供内部参考，请勿外传

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业分化显著，涨跌幅排名前三的细分赛道分别为品牌消费电子（+5.43%）、模拟芯片设计（+2.48%）、面板（+1.39%）；涨跌幅排名后三的细分赛道分别为被动元件（-11.18%）、集成电路封测（-8.64%）、LED（-7.39%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



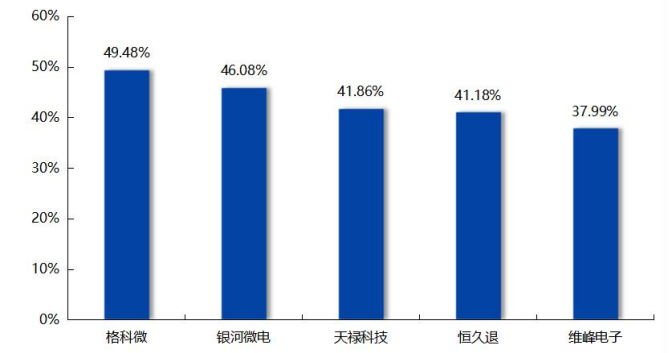
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子个股行情分化显著，格科微（+49.48%）、银河微电（+46.08%）、天禄科技（+41.86%）、恒久退（+41.18%）、维峰电子（+37.99%）为本周板块领涨标的；消费电子、PCB 相关标的整体承压回调，板块跌幅前五个股依次为昀冢科技（-30.91%）、唯特偶（-23.96%）、沃格光电（-22.98%）、富信科技（-22.16%）、超声电子（-22.03%）。

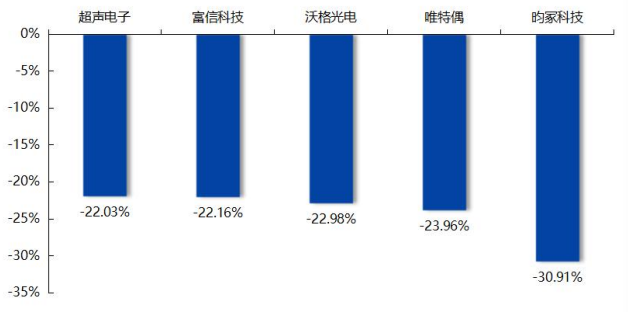
仅供内部参考，请勿外传

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

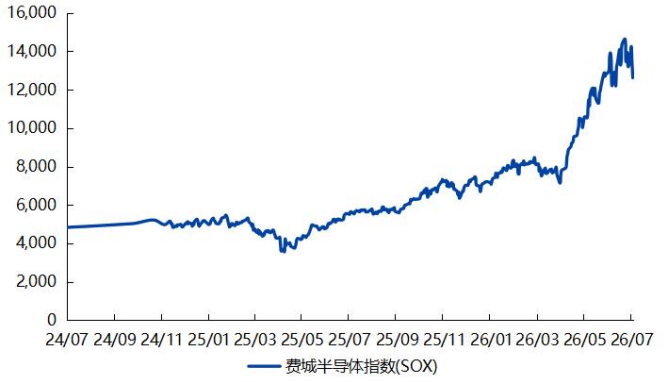


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

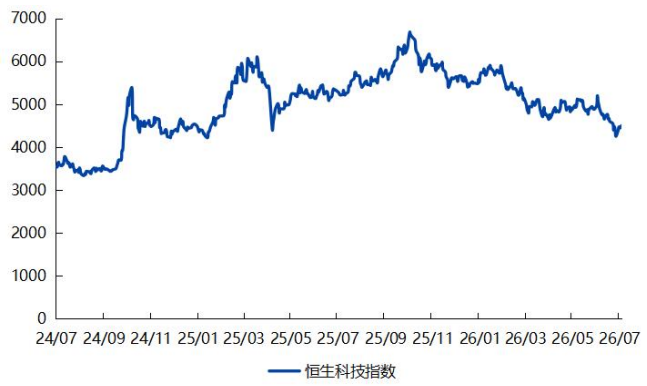
费城半导体指数（SOX）本周涨跌幅为-4.37%，恒生科技指数本周涨跌幅为+5.72%。

图表 5：本周费城半导体指数涨跌幅为-4.37%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 6：本周恒生科技指数涨跌幅为+5.72%

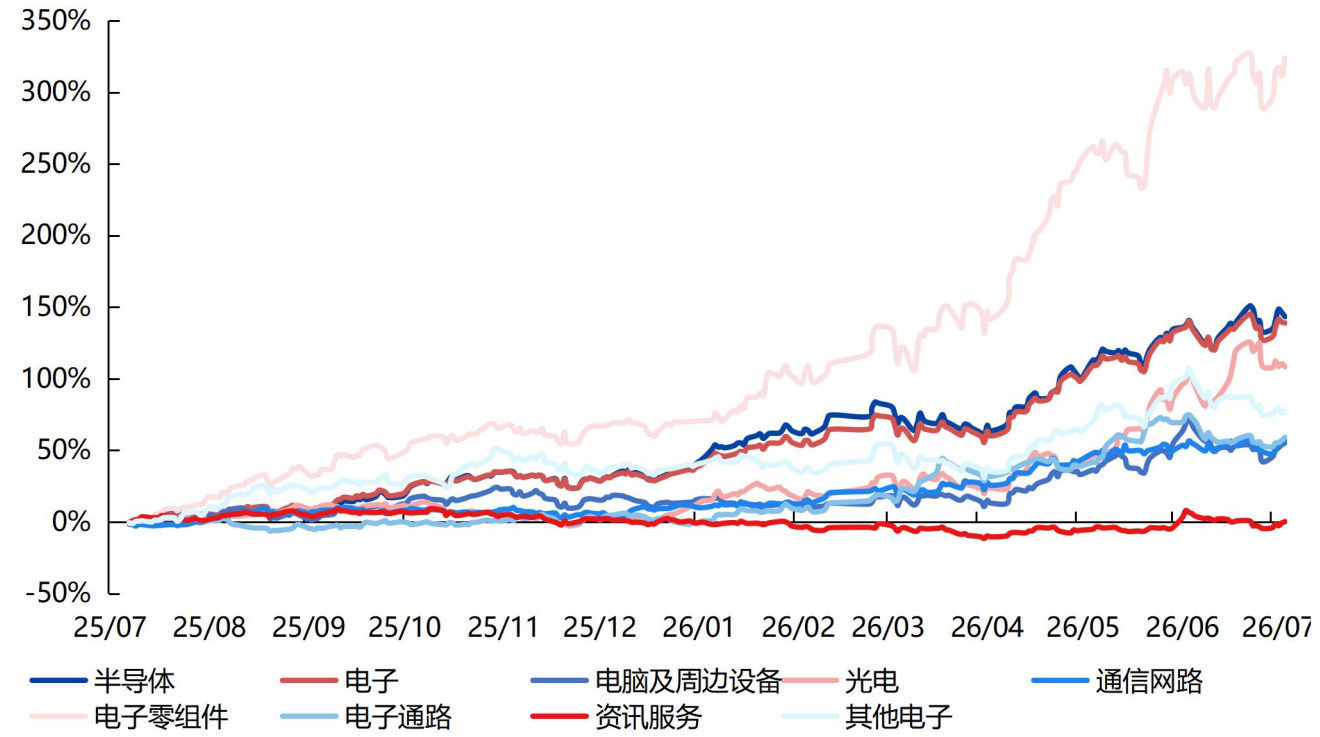


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为：电脑及周边设备（+9.39%）、电子零组件（+9.10%）、电子（+5.32%）、通信网路（+5.10%）、资讯服务（+5.09%）、半导体（+4.68%）、电子通路（+3.92%）、其他电子（+1.51%）、光电（-0.03%）。

仅供内部参考，请勿外传

图表 7：2025 年 7 月-2026 年 7 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 江波龙发布 2026H1 业绩预告

新闻：2026 年 7 月 3 日，国产存储芯片厂商江波龙发布 2026H1 业绩预告。公司预计 2026H1 实现营业收入 220 亿元–250 亿元，同比增长 116%-145%；归母净利润区间 92 亿元–110 亿元，同比增幅高达 62204%-74394%。

公司表示业绩增加源于：存储行业需求向好、晶圆供给偏紧带来高景气周期；同时公司与多家全球主要存储晶圆原厂续签了晶圆供应协议（LTA，即长期供货协议）和谅解备忘录（MOU），保障了上游晶圆供应。

爱建观点：存储行业供需格局持续改善，公司长期锁定晶圆产能充分受益存储涨价周期，国产存储芯片业务盈利弹性充分释放，有望带动国内消费级、企业级存储产业链景气持续上行。

2.2 华为发布“韬定律”V2 版论文，补充工程细节和实测数据

新闻：2026 年 7 月 3 日，华为半导体何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2 版本。对比此前发布的 V1 版本，新版论文在原有理论框架之上补充大量工程落地细节、量化实测数据与产品迭代路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代芯片缩放理论体系：

1）工程落地层面：V2 版本完整阐释 LogicFolding（逻辑折叠）的齿比（gear ratio）

仅供内部参考，请勿外传

核心概念：当混合键合间距逼近顶层金属布线尺寸时，3D 芯片设计空间可从传统“宏块级离散分层优化”升级为“标准单元级连续全局优化”，能够实现垂直逻辑划分全局最优解，打破传统 3D 堆叠仅能按功能模块分层设计的固有局限。

2）量化实测数据层面：论文完整披露麒麟 2026 与基准芯片麒麟 9030 Pro 的电压、主频、归一化功耗、裸片面积及功率密度全套对比参数。在 25℃、同等算力测试条件下：芯片工作电压由 1.1V 降至 0.9V；基准芯片主频 2.75GHz，麒麟 2026 仅需 2.5GHz 即可实现同等运算性能；归一化功耗为前代 0.59，整体功耗下降 41%；归一化裸片面积 0.625，芯片尺寸缩减 37.5%；功率密度为 0.944，单位面积发热得到小幅优化。

3）全场景技术路线层面：V2 版本细化覆盖移动端、AI 端的完整技术演进路线图。移动端维度，新增 TSV 硅通孔由顶层金属下移至 M6 层、多层有源晶圆堆叠等工艺迭代路径；AI 算力维度，明确昇腾系列加速器迭代节奏，并围绕统一总线 Unified Bus、Hi-ONE 硅光引擎等核心技术，完整展示中长期技术演进方向。

爱建观点：华为本次发布的时间缩微理论 V2 版本完成量产数据验证，打通 3D 堆叠、逻辑折叠、硅光互联完整技术链路，移动端与 AI 算力芯片迭代路径清晰，夯实公司先进封装、高性能计算核心技术壁垒，有望带动国内先进芯片、混合键合、硅光产业链景气持续上行。

2.3 国巨 7 月 1 日起全系列电容产品涨价

新闻：据中国台湾经济日报 2026 年 7 月 1 日报道：全球被动元件龙头国巨自 7 月 1 日起上调全系列电容解决方案产品售价，调价品类覆盖 MLCC 陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容，电容业务营收约占公司整体收入的 50%。

本次涨价按产品品类差异化制定涨幅：通用消费级 MLCC 涨价 20%-40%；适配 AI 服务器、新能源车的高容高频主力 MLCC 涨幅超 40%，市面紧缺规格调价幅度进一步走高；钽电容、铝电解、薄膜电容、超级电容均同步实施阶梯涨价。

此次全品类调价核心源于成本与需求双重压力：1）银、钽、钯等贵金属及封装化工材料价格高位运行，能源、海运物流成本持续抬升，公司依靠工艺、产能优化已无法消化成本压力。2）需求端，AI 算力、新能源车带动电容需求持续增长，高容高可靠型号产能持续满载；原厂优先保障长协大客户供货，中小批量订单交期进一步拉长。

爱建观点：国巨全系列电容涨价验证行业景气上行，AI 服务器、新能源车拉动高端 MLCC 需求增量明确，建议关注 MLCC 及高端电容产业链投资机会。

2.4 KIOXIA 与 Sandisk 启动 332 层 BiCS10 闪存样品交付

新闻：2026 年 7 月 3 日，KIOXIA 与 Sandisk 联合宣布,双方协同研发的第十代 BiCS

仅供内部参考，请勿外传

FLASH 3D 闪存正式启动工程样品交付。本次送样产品为 1Tb TLC 闪存芯片，采用 332 层存储堆叠架构，由 KIOXIA Fab2 晶圆厂专属产线制造。

第十代 BiCS FLASH 完整延续第八代落地的两大核心底层技术：CMOS 阵列直接键合（CBA）、节距选通（OPS），两项架构可在高层堆叠方案中兼顾存储密度、存储单元可靠性与功耗表现。产品 I/O 接口支持 Toggle DDR6.0，最高传输速率 4800MT/s，存储密度超 29Gb/mm²，较第八代 BiCS 提升 59%；功耗层面优化幅度突出：输出功耗下降 34%、读取能效提升 30%，输入功耗降低 10%、写入能效提升 18%。芯片兼容 SCA、PI-LTT 配套协议，主要面向 AI 数据中心、企业级高性能 SSD 市场。

爱建观点：KIOXIA 与 Sandisk 共同推出 332 层第十代 BiCS FLASH 并送样，存储密度、能效大幅优化，适配 AI 数据中心高性能 SSD 需求，看好高端 3D NAND 产业链景气度。

3. 风险提示

1）海外厂商 3D 集成、硅光技术迭代速度超预期：TSMC、Samsung 持续迭代 SoIC、3D 堆叠与硅光封装工艺。若海外大厂加速新一代立体集成方案扩产，高端芯片市场竞争将加剧，压缩国内先进封装、硅光企业盈利空间，延缓国产技术替代节奏。

2）国产逻辑折叠、多层晶圆堆叠量产良率爬坡不及预期：当前海外厂商已实现多代 3D 芯片稳定量产，若国内厂商在标准单元级逻辑折叠、有源晶圆堆叠、硅光引擎良率提升等核心环节落地滞后，将持续拉大与海外龙头产品代差，难以充分承接 AI 算力、高端移动芯片增量红利。

仅供内部参考，请勿外传

爱建证券
AIJIAN SECURITIES

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号
电话：021-32229888　　传真：021-68728700　　服务热线：956021
邮政编码：200124　　邮箱：ajzq@ajzq.com　　网址：http://www.ajzq.com

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050. BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%～15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归属爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。